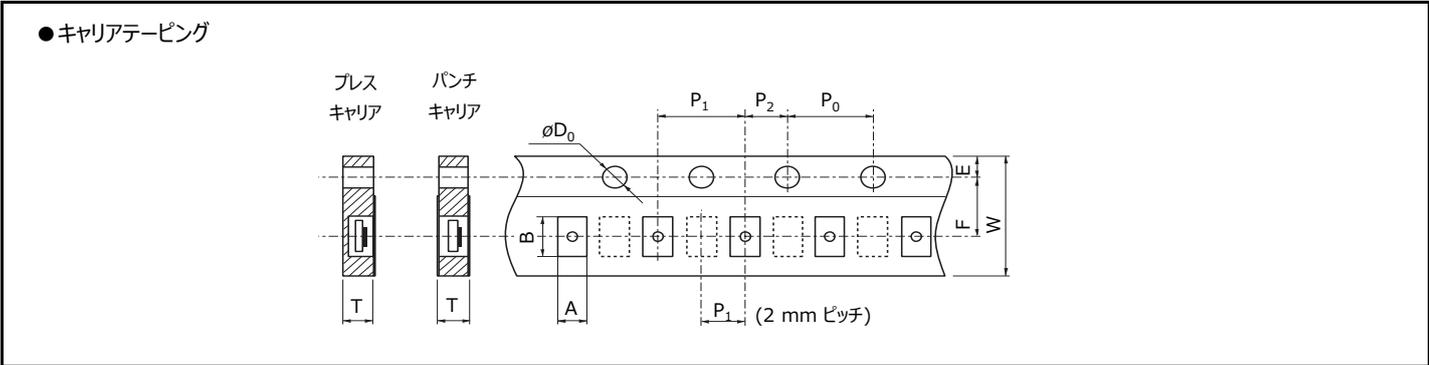


**包装方法 (テーピング)**

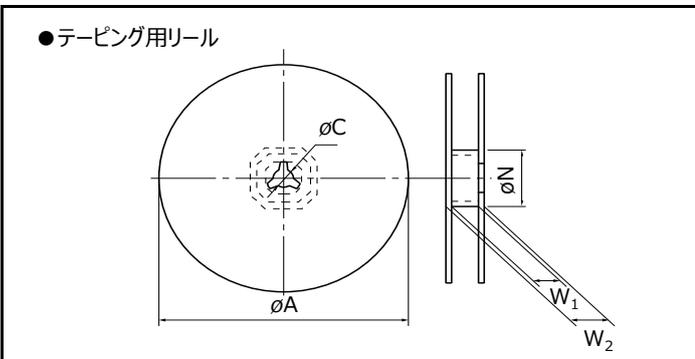
●標準数量

品番	サイズ	タイプ	テーピングの種類	ピッチ(P <sub>1</sub> ) (mm)	数量 (pcs / リール)
EZAEG1N	0603	単品	プレスキャリアテーピング	2	15000
EZAEG2A,2N	1005				10000
EZAEG3A	1608				5000
EZAEG3W	1608	アレイ	パンチキャリアテーピング	4	4000
EZAEGCA	2012				5000



単位: mm

品番	サイズ	A	B	W	F	E	P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>	P <sub>0</sub>	φD <sub>0</sub>	T
EZAEG1N	0603	0.38±0.05	0.68±0.05	8.00±0.20	3.50±0.05	1.75±0.10	2.00±0.10	2.00±0.05	4.00±0.10	1.5 <sup>+0.1</sup> <sub>0</sub>	0.42±0.05
EZAEG2A,2N	1005	0.70±0.05	1.20±0.05								0.60±0.05
EZAEG3A	1608	1.10±0.10	1.90±0.10				0.70±0.05				
EZAEG3W	1608	0.91±0.10	1.82±0.10				1.08±0.10				
EZAEGCA	2012	1.55±0.15	2.30±0.20				0.85±0.05				



寸法		
φA	φN	φC
180.0 <sup>0</sup> <sub>-1.5</sub>	60.0 <sup>+1.0</sup> <sub>0</sub>	13.0±0.2

寸法	
W <sub>1</sub>	W <sub>2</sub>
9.0 <sup>+1.0</sup> <sub>0</sub>	11.4±1.0

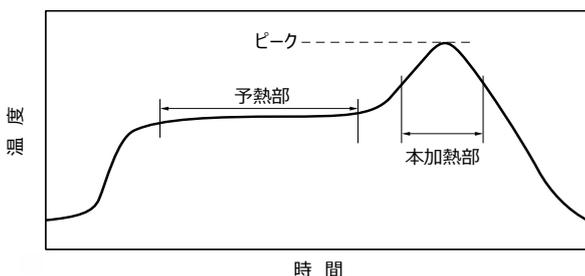
単位: mm

**推奨はんだ付け条件**

以下に、本製品の推奨はんだ付け条件に関する推奨条件及び注意事項を示します。

●リフローはんだ付け推奨条件

- ・リフローは 2 回まででご利用ください。
- ・保証温度を超える場合は、必ずご相談ください。
- ・基板及びはんだの種類毎に、製品端子部の温度及びはんだ付け性を予めご確認ください。



共晶はんだの場合 (Sn/Pb 系など)

	温度条件	時間
予熱部	140 °C ~ 160 °C	60 秒 ~ 120 秒
本加熱部	200 °C 以上	30 秒 ~ 40 秒
ピーク	235 ± 5 °C	10 秒以内

鉛フリーはんだの場合 (Sn/Ag/Cu 系など)

	温度条件	時間
予熱部	150 °C ~ 180 °C	60 秒 ~ 120 秒
本加熱部	230 °C 以上	30 秒 ~ 40 秒
ピーク	max. 260 °C	10 秒以内